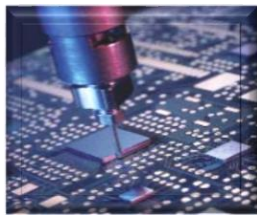
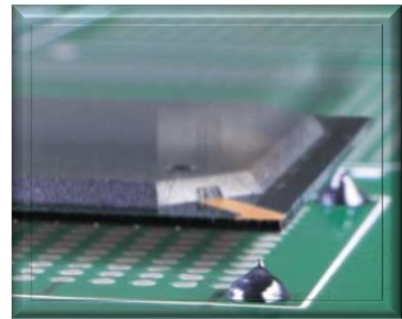
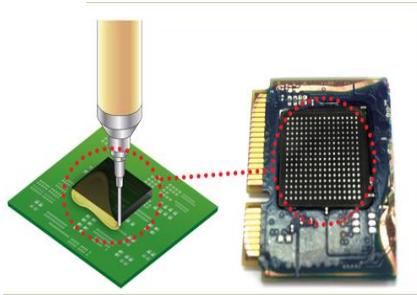


용 도

NEOBON™ UF-7200 SERIES는 실장된 BGA, CSP, FLIP CHIP 등의 부품들이 물리적, 화학적 충격에 의해 발생하는 Package와 PCB의 접착불량을 방지하기 위해 사용되는 UNDER FILL, CONNER FILL용 열경화성 일액형 EPOXY 접착제이며 경화 및 침투속도가 빠릅니다.



일반물성

항 목	단 위	NEOBON™ UF-7200B/7200Y	NEOBON™ CF-7230B	NEOBON™ UF-7250B	비 고
용도	-	UNDER FILL	CONNER FILL	UNDER FILL	
외관	-	검정/노랑 LIQUID	Black	Black	
점도	cps	2,000 ± 500	12,000 ± 1,000	60,000 ± 5,000	
경화특성	°C@Sec	120°C@ 5분	120°C@ D5분	150°C@ 60분	
동판부식	-	없음	없음	없음	
흡수율	wt%	1.0 ↓	1.0 ↓	1.0 ↓	
절연저항	Ω	1 × 10 ¹² ↑	1 × 10 ¹² ↑	1 × 10 ¹² ↑	
유리전이온도(Tg)	°C	14°C	80°C	120°C	
침투속도(18mm×18mm)	Min@상온	5 Min 이내		1 Min 이내(100°C)	
열팽창계수(CTE)	Ppm(α1/α2)	50/210	50/210	25/110	
보관조건	°C	5 ~ 10	5 ~ 10	-20	
보증기한	Mon	6 (상온 7일)	6 (상온 7일)	6 (상온 1일)	